

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 실용신안공보(Y1)

(51) Int. Cl.⁵
H01C 21/68

(45) 공고일자 1993년 11월 24일
(11) 공고번호 실 1993-0007910

(21) 출원번호	실 1990-0010255	(65) 공개번호	실 1992-0003416
(22) 출원일자	1990년 07월 13일	(43) 공개일자	1992년 02월 25일
(71) 출원인	금성일렉트론주식회사 문정환 충청북도 청주시 향정동 50번지		
(72) 고안자	노용수		
(74) 대리인	경상북도 상주군 공성면 평천 2리 1004번지 신관호		

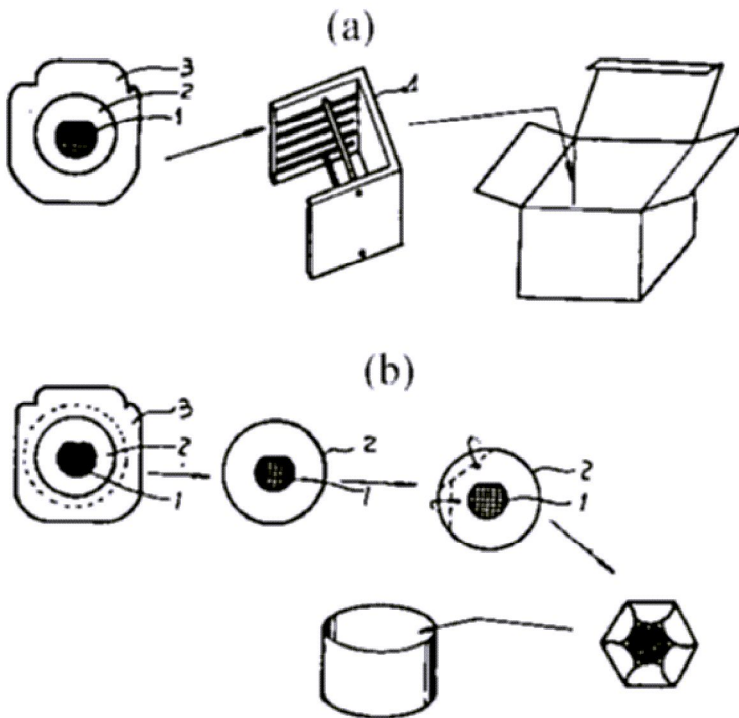
심사관 : 박충범 (책)
자공보 제1853호)

(54) 링을 사용한 스크라이브 웨이퍼 포장구조

요약

내용 없음.

대표도



명세서

[고안의 명칭]

링을 사용한 스크라이브 웨이퍼 포장구조

[도면의 간단한 설명]

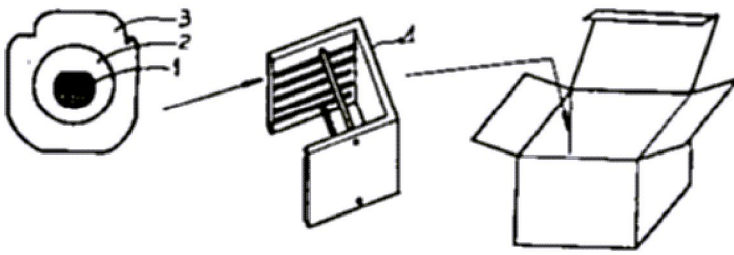
제 1 도는 종래의 웨이퍼 포장 상태도인 것으로, (a)는 소잉(sawing)이 끝난 후 프레임에 메거진에 꽃은 채로 층에 포장하는 상태도, (b)는 소잉(sawing)후 프레임을 떼어내고 호일을 접고 통에 포장하는 상태도.

제 2 도는 본 고안에 의한 웨이퍼 포장 순서도.

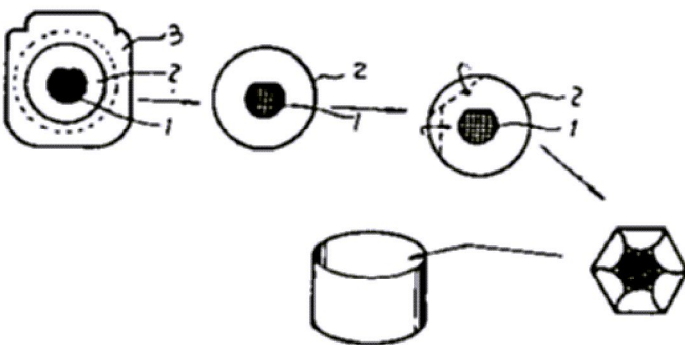
제 1 항에 있어서, 상기 링(6)이 종이재인 것을 특징으로 하는 링을 사용한 스크라이브 포장구조.

도면

도면1a



도면1b



도면2

